

平成 30 年度 第 1 回 ホットスタンピング研究部会案

[次 第]

日時:平成 30 年 10 月 5 日(金)10:00~17:00

会場:機械振興会館 6階 6D-4 (東京都港区芝公園3-5-8)

10:00-11:10 「ヨーロッパのホットスタンピングの状況」

ゲストンプ・ホットスタンピング・ジャパン(株) 原 俊哉 氏

11:10-12:00 「高周波加熱のホットスタンピング」

アイシン精機(株) 林 貴文 氏

12:00-12:50 休憩

12:50-13:50 「第 17 回塑性加工国際会議 “6th International Conference on Metal Forming”の発表論文報告」

東京工業大学 中川 佑貴 氏

13:50-14:40 「板鍛造ホットスタンピングの開発」

横浜国立大学 前野 智美 氏

14:40-15:30 「ホットスタンピング部材へのボルトおよびナットの冷間穴抜き接合」

東亜工業(株) 鈴木 康剛 氏

15:30-15:50 今後の活動内容

15:50-16:00 休憩

16:00-17:00 意見交換会